

N800D

低アウトガス性ノンシリコン熱伝導シート

高熱伝導性・低汚染リスク・高絶縁信頼性

23.0 W/m·K

熱伝導率
ASTM D5470

8.5 KV/mm

絶縁破壊電圧
ASTM D149

70 Shore 00

硬さ
ASTM D2240

製品特長

LiPOLY N800Dは、ノンシリコン樹脂を採用した高性能熱伝導性インターフェース材料です。低分子量シロキサンの揮発（アウトガス）の可能性を低減し、清浄度、信頼性、汚染管理への要求が高い電子機器、光電分野、および高度な熱管理が求められる用途に適しています。N800Dは23.0 W/m·Kの高い熱伝導率を備え、優れた熱伝導性と放熱性能を発揮します。Shore 00 70の硬度と良好な柔軟性・圧縮性により、界面の隙間を効果的に埋め、部品にかかる機械的応力を低減します。さらにN800Dは8.5 KV/mmの絶縁破壊電圧を備え、信頼性の高い電気絶縁性能を提供します。高い熱伝導性、機械的追従性、低汚染性を兼ね備えており、AIサーバー、光通信、精密光学機器、半導体製造装置、低軌道衛星、航空宇宙電子機器など、高信頼性が求められる熱管理用途に適しています。



ノンシリコン
ノンシリコン樹脂

低アウトガス性
ASTM E595準拠

耐電圧
低い機械的応力：高い絶縁強度

優れた熱伝導率
高熱伝導率：23.0 W/m·K

柔軟性と圧縮性
優れた柔軟性と圧縮性

高信頼性
高清浄度が求められる用途に最適

代表的な用途

AI / HPC	GPU, ASIC, HBM, VRM
光通信	800G / 1.6T 光トランシーバー、シリコンフォトニクス
半導体製造装置	ウェハ検査、計測、真空装置
光学システム	光学システム — カメラ、LiDAR、レーザー
車載電子機器	ADAS、ドメインコントローラー、レーダー
通信機器	5G / 6G、ネットワーク機器、エッジコンピューティング
衛星・航空宇宙	衛星電子機器、ペイロード、通信モジュール

| 性能特長

熱特性

- 高い熱伝導率
- 優れた熱伝導性と放熱性能
- 低い熱抵抗

電気特性

- 高い絶縁強度
- 信頼性の高い電気絶縁性能
- 高出力ハイパワーの電子機器用途に対応適合

機械特性

- 優れた柔軟性と圧縮性
- 良好な表面追従性、凹凸のある表面にも対応可能
- 部品にかかる機械的応力を低減

信頼性

- 長期的に安定した熱性能
- 低アウトガス特性により、汚染リスクを低減
- 過酷な動作条件下でも高い信頼性を保持

| 信頼性ハイライト

信頼性試験は、以下に記載の試験条件で実施しています。試験結果は試験条件やサンプル構成により異なる場合があります。
試験方法：ASTM D5470 / 単位：°C・in²/W

試験項目	試験条件	試験結果	試験方法
高温	125°C, 1000 hrs.	合格	内部試験方法
高温 / 高湿	85°C / 85% RH, 1000 hrs.	合格	内部試験方法
冷熱衝撃	40°C ↔ 125°C, 500 cycles	合格	内部試験方法
低温	-60°C, 1000 hrs.	合格	内部試験方法

| 推奨使用方法

1. 取り付け前に、接合面が清潔で乾燥しており、汚染物質がないことを確認してください。
2. 実際の隙間および部品公差に応じて、適切な材料厚みを選択してください。
3. 取り扱いは慎重に行い、過度な引き伸ばし、折り曲げ、繰り返しの操作は避けてください。
4. 均一に圧縮し、材料と接合面が十分に接触するようにしてください。
5. 材料の不要な変形を防ぐため、過度な圧縮は避けてください。
6. 大面積に適用する場合は、空気の巻き込みを減らすため、段階的に貼り付けることを推奨します。
7. 組み立て完了後、最終的な接触状態および圧縮度を確認してください。

| 取扱いガイドライン

保管および取り扱い - N800Dは、開封前の元の包装のまま、室温・乾燥・清潔な環境で保管してください。保管中は直射日光、高温、湿気、汚染を避けてください。運搬および取り扱いの際は、材料の損傷や表面状態への影響を避け、丁寧に扱ってください。